

★刊行書籍のご案内:合成樹脂工業協会★

半導体封止材ハンドブック(A5版)

2020年6月刊行 A5版 133頁 定価(税込、送料別) 2,500円(会員企業), 3,500円(一般)

エレクトロニクス材料部会では、2014年に手帳サイズ版を発刊しましたが、大変ご好評を頂き完売、お問い合わせを頂戴してもお応えできない状態でした。そこでこの度、再版のご要望にお応えし、加えて、より大きなA5版とする事で発刊致しました。内容はそのままに、サイズを大きくした事でより見やすく、使いやすくなったのではないかと思います。皆様にご利用頂ければ幸いです。



目次

第1章 はじめに

- 1.1 半導体封止材の市場
- 1.2 半導体パッケージと封止材

第2章 封止材・アンダーフィル材の目的と必要特性

- 2.1 半導体封止材と封止動向
- 2.2 各原料の構成比率と主要な役割
- 2.3 トランスファー成形材料(固形)
- 2.4 液状封止材

第3章 封止材の原材料

- 3.1 エポキシ樹脂
- 3.2 硬化剤(フェノール樹脂:硬化剤・エポキシ樹脂原料)
- 3.3 アミン系硬化剤
- 3.4 酸無水物系硬化剤
- 3.5 硬化促進剤
- 3.6 フィラー
- 3.7 その他添加剤

第4章 封止材の使用方法

- 4.1 封止材の保管方法と取り扱い方法
- 4.2 金型成形法(トランスファー成形)
- 4.3 ディスペンサ法・印刷法(塗布方法)

第5章 封止材、及びパッケージの評価方法

- 5.1 封止材の材料基本物性(一般特性、作業性)
- 5.2 パッケージとしての特性評価項目(または信頼性試験)

合成樹脂工業協会

Japan Thermosetting Plastics Industry Association

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング 6階

TEL:03-5298-8003 FAX:03-5298-8004

URL <http://www.jtpia.jp>